

Disclosure

信息披露 /14

●2020年1月10日 星期五 上海證券報

(上接13版)

本次发行前,公司国家股、国有法人股东及持股情况如下:				
序号	股东名称或姓名	持股数(万股)	持股比例	
1	国家集成电路基金(SI)	2,591.96	7.00%	
2	上海科技(SI)	90.00	0.24%	

公司股东中不存在外资股股东的情形。
(三) 发行人的发起人、控股股股东和主要股东之间的关联关系
本次发行前,发行人的发起人、控股股股东和主要股东之间的关联关系如下:

励民、黄旭为一致行动人,公司控股股东、实际控制人。
励民为润科控股有限公司,持有68.58%的合伙份额。
国家集成电路基金为上海武岳峰有限合伙人,持有其27.75%的合伙份额。
除上述关联关系外,本次发行前发行人的发起人、控股股股东和主要股东之间不存在其他关联关系。

四、发行人的主要业务情况

(一) 主营业务

公司主营业务为大规模集成电路及应用方案的设计、开发和销售,为客户提供芯片相关产品及服务。

自成立以来,公司一直从事集成电路设计行业,公司是国家级高新技术企业和经工业和信息化部认定的集成电路设计企业,经过近二十年的创新发展,已经成为国内集成电路设计行业的优势企业。

(二) 主要产品及用途

公司主要产品为智能应用处理器芯片、电源管理芯片及其他芯片,同时提供专业技术服务和与自研芯片相关的组合器件。

1. 智能应用处理器芯片

智能应用处理器芯片,是在低功耗中央处理器的基础上扩展音视频功能和专用接口的超大规模集成电路,是智能设备的“大脑”,在智能设备中起着运算及调用其他功能构件的作用,集成了中央处理器、图形处理、视频编解码器、显示控制器、总线控制器、内存系统、音频处理器、输入输出系统以及各类高速模拟接口等功能模块。智能应用处理器芯片在满足高性能运算的同时,大幅降低了功耗,缩小了芯片的物理面积,加强了多媒体处理能力,丰富了用户输入输出方式,使得智能设备具备体积小、功耗低、发热少、操作便捷、用户体验好等特点。通常来说,智能应用处理器芯片加上存储器、电源管理芯片等少数其他芯片便可与电池、外观件等部件一起组成智能设备。

目前,公司的智能应用处理器芯片可以划分为消费电子和智能网联两大应用领域。

① 消费电子应用领域

消费电子市场以个人消费者为主,公司的SoC芯片主要应用于平板电脑、智能盒子、智能手机等消费电子产品。消费电子产品市场需求巨大,消费者对产品的持续提升,消费电子产品的升级换代、嵌入式CPU设计技术的快速发展、产业政策的大力支持,为消费电子应用处理器芯片产品的持续发展奠定了坚实的基础。

报告期内,公司在消费电子应用领域推出了一系列性价比比较高的SoC芯片,同时基于自主创新的核心技术,公司端端SoC芯片产品正逐步进入国际高端消费电子市场。2016年8月,公司成为三星Chromebook Plus笔记本电脑(采用谷歌Chrome系统)处理器的供应商,实现了中国大陆芯片厂商进入国际科技巨头高端产品应用处理器芯片核心供应链,该款笔记本电脑荣获国际消费电子产品展览会(CES)顶级科技大奖。2018年3月,公司又成为全球首台采用谷歌Chrome系统的宏碁Chromebook Tab 10平板电脑处理器的供应商。

② 智能网联应用领域

智能网联市场以商业应用为主,公司的SoC芯片广泛应用于智慧商显、智能零售、汽车电子、智能安防等智能物联领域。近年来,人工智能技术逐渐成熟,互联网、物联网、新零售等新的经济形态和智能应用领域不断涌现,推动全球智能应用处理器芯片市场进入新一轮增长。公司顺应经济发展趋势,持续加大研发投入,凭借SoC芯片产品的安全性和稳定性优势,逐步进入智能物联应用领域各细分市场,并已取得良好的成效,实现了多元化的产品应用。

2. 电源管理芯片

电源管理芯片,是承担电能变换、分配、检测及其他电能管理职责的芯片。公司开发和量产一系列与智能应用处理器SoC芯片相配套的电源管理芯片。2016年底,公司与国内主要手机厂商之一的OPPO达成战略合作,为其定制开发了低电压大电流高集成度快速充电管理芯片,与普通的电源管理芯片相比,在占用面积、能量转换效率和散热量等方面均有较大程度的优化,性能和可靠性指标均处于市场领先水平。

3. 其他芯片

公司的其他芯片包括音频专用芯片、无线连接芯片、接口扩展芯片等,主要用于实现音频播放、无线连接、接口扩展等功能。

4. 技术服务

公司在设计、开发和销售芯片产品的同时,还为客户提供技术服务,主要包括技术开发服务和技术咨询及服务,技术开服务,主要是依靠公司自身的技术优势和市场化资源,与英特尔、谷歌等国际大型企业合作,为其提供特定领域的技术开发服务。技术咨询及服务,主要是为客户提供软件开发工具、硬件参考设计等服务,以便其在自己的芯片产品上进行再次开发或产业化、技术授权,主要是向客户提供软件、软件等技术授权。

5. 组件

组件是搭载公司自研芯片的组件件,为公司2019年新开发产品,包括开屏半导体件、开发板、嵌入式人工智能计算,主要面向电子产品开发者或爱好者等终端用户。

开屏半导体件(开发板),是指公司设计的标准化开发工具,包括中央处理器、存储器、输入输出设备和外部接口等组件,可用于项目评估、功能验证、应用开发等,缩短产品研发及量产周期,还可用于算法研究、高校教学实验和课题研究等。

人工智能计算,是指具备人工智能编程及深度学习能力的板级开发工具,可以作为AI加速器,在各场景的开发应用中,使原型设备运行得更加快速、智能。

(三) 公司的主要业务模式

作为集成电路设计企业,公司采用行业常用的Fables经营模式,即专门从事集成电路的研发设计,晶圆制造和封装测试,芯片封装和测试均委托专业的集成电路制造企业、封装测试企业完成,取得芯片成品后对外销售并提供技术服务。

1. 研发设计模式

公司坚持“敢于需求、找准痛点、发挥优势、服务市场”的研发理念,建立了以技术创新为引领的前瞻性策略和以市场需求为导向的策略性策略相结合的研发模式,量产一代、预研一代。对重大的新产品布局,以前瞻性策略为主,通过预判未来市场发展方向,提前一至两年开展相关产品研发,对已有产品线进行迭代或升级,以市场需求为导向,根据客户的具体需求对已产品进行改良、优化提升。

公司研发工作由总经理负责,常设管理机构为总工程师办公室,设置芯片设计、应用开发、技术平台和工程验证四大类职能部门。芯片设计部门负责芯片、固件、版图设计、应用开发部负责客户模块开发和样机设计,技术平台部门负责提供技术支持,工程验证部门负责研发全过程的测试验证和质量管控。

2. 采购生产模式

公司为晶圆制造和电路设计企业,专注于从事设计与销售环节,生产模式为委外生产,向晶圆厂商采购晶圆,向封装测试厂商采购封装测试服务。公司建立了较为严格的采购管理制度,对采购商的选择和调整、生产流程的监督和和管理等进行了详细规定,形成了由质控部、采购部、研发中心、业务部及财务部等多部门参与、协同联动的采购机制,确保对供应链管理的有效性。

3. 技术服务模式

公司提供技术服务,主要包括技术开发服务、技术咨询服务和技术服务。

相应地,公司在三种技术服务模式:一是根据客户需求,整合公司技术资源,为客户提供技术开发服务;二是为客户提供开发软件工具包、硬件参考设计等技术咨询服务;三是向客户提供算法、软件等技术授权。

4. 销售模式

公司采用“经销为主、直销为辅”的销售模式。公司建立了较为健全的信用政策,定期对客户的信用状况进行评估,根据客户的信用情况给予不同的信用额度和信用期限,对部分交易金额较大或新增客户预收部分或全部账款,最大限度地减少发生坏账的风险。

在经销模式下,经销商向公司采购芯片后销售给终端客户或方案商,公司与经销商签订经销框架性协议,每笔销售再以订单形式进行,公司与经销商的合作方式以买断式销售,即公司将商品销售给经销商后,商品的所有权已转移至经销商。经销商在采购公司产品后,除产品出现质量问题,并经公司确认后以要求退换货外,其他情况均不得要求退换货,经销商自行承担产品售后、库存等风险。该模式下,公司始终持续,密切跟踪经销商至终端客户在产品开发、市场推广等方面的动态信息,确保公司了解主要终端客户的需求,及时给予技术支持,在很大程度上缓解了传统经销模式带来的信息不畅和市场营销难度大的风险。

在直销模式下,公司直接向整厂厂、方案商销售芯片,或提供专业技术服务。整厂厂直接采购芯片用于生产智能终端产品;方案商具有一定的技术开发和器件组装能力,采购芯片后经过二次开发,形成一套包括芯片、存储器、显示屏、印刷电路板、接口接口等在内的应用方案并销售给整厂厂等终端客户;整厂厂、方案商根据具体产品应用或其他需求,向公司购买技术开发服务或技术咨询。

四、发行人主要原材料、能源及其供应情况

1. 主要原材料采购情况
作为Fables模式集成电路设计企业,晶圆和封装测试服务是公司采购的主要原材料,报告期内,公司原材料采购价格受产品结构变化等因素影响有所波动,具体情况如下:

年度	类别	金额(万元)	数量	单位(元/个)
2019年1-6月	晶圆代工	9,863.85	12,975 个	7,602.20
	封装测试	7,158.90	4,522.70 万颗	1.58
2018年度	晶圆代工	51,487.92	41,275 个	12,474.36
	封装测试	15,865.32	8,687.79 万颗	1.83
2017年度	晶圆代工	53,530.51	35,506 个	15,076.47
	封装测试	15,025.84	7,316.47 万颗	2.05
2016年度	晶圆代工	55,081.67	34,328 个	16,045.70
	封装测试	16,099.26	6,246.11 万颗	2.67

注:封装测试采购金额包括芯片封装、芯片测试采购金额

2. 主要能源及供应情况
公司主要从事生产环节,能源需求主要为办公用电用水,价格较为稳定,相关成本在总成本中占比较小。

三、前五大供应商采购情况

报告期内,公司前五名供应商采购情况如下:

年度	序号	供应商名称	采购金额	占比	采购内容
2019年1-6月	1	格罗方德	5,774.99	31.00%	晶圆代工
	2	砂晶精密工业股份有限公司小计	3,584.58	28.91%	-
	3	砂晶科技(苏州)有限公司	5,260.05	-	封装测试
	4	中芯国际集成电路制造有限公司小计	124.83	0.67%	封装测试
	5	中芯国际集成电路制造有限公司(上海)有限公司	4,044.86	21.72%	-
2018年度	1	中芯国际集成电路制造有限公司小计	2,647.40	14.21%	晶圆代工
	2	中芯国际集成电路制造有限公司(上海)有限公司	1,937.45	7.50%	晶圆代工
	3	迈瑞科技(苏州)有限公司小计	1,937.95	5.02%	-
	4	迈瑞科技(苏州)有限公司	934.11	5.01%	封装测试
	5	联元电子股份有限公司	1.84	0.01%	封装测试
2017年度	1	天水华天科技股份有限公司小计	809.40	4.35%	-
	2	华天科技(西安)有限公司	804.42	4.32%	封装测试
	3	天水华天科技股份有限公司	4.97	0.03%	封装测试
	4	砂晶精密工业股份有限公司	16,949.78	91.00%	-
	5	合计	16,949.78	91.00%	-

2018年度	1	格罗方德	40,820.48	58.60%	晶圆代工
	2	砂晶精密工业股份有限公司小计	13,061.61	18.75%	-
	3	砂晶科技(苏州)有限公司	12,651.69	18.16%	封装测试
	4	中芯国际集成电路制造有限公司小计	409.91	0.59%	封装测试
	5	中芯国际集成电路制造有限公司(上海)有限公司	10,643.86	15.28%	-
2017年度	1	中芯国际集成电路制造有限公司小计	6,707.45	9.40%	晶圆代工
	2	中芯国际集成电路制造有限公司(上海)有限公司	3,897.20	5.59%	晶圆代工
	3	中芯国际集成电路制造有限公司(天津)有限公司	39.21	0.06%	晶圆代工
	4	迈瑞科技(苏州)有限公司	1,471.48	2.11%	封装测试
	5	华天科技(西安)有限公司小计	1,313.11	1.91%	-
2016年度	1	华天科技(西安)有限公司	1,313.37	1.89%	封装测试
	2	天水华天科技股份有限公司	17.35	0.02%	封装测试
	3	合计	67,328.54	96.65%	-
	4	格罗方德	29,323.04	37.50%	晶圆代工
	5	砂晶精密工业股份有限公司小计	13,141.91	16.81%	-
2015年度	1	砂晶精密工业股份有限公司小计	12,633.69	16.16%	封装测试
	2	砂晶科技(苏州)有限公司	598.22	0.65%	封装测试
	3	台湾积体电路制造股份有限公司	12,981.22	15.73%	晶圆代工
	4	中芯国际集成电路制造有限公司小计	11,909.36	15.23%	-
	5	中芯国际集成电路制造有限公司(北京)有限公司	7,929.78	10.44%	晶圆代工
2014年度	1	中芯国际集成电路制造有限公司(上海)有限公司	3,920.77	5.01%	晶圆代工
	2	中芯国际集成电路制造有限公司(天津)有限公司	58.82	0.08%	晶圆代工
	3	WPI International Hong Kong Limited	5,807.16	7.43%	封装材料
	4	合计	72,475.58	92.69%	-
	5	格罗方德	31,615.02	35.27%	晶圆代工
2013年度	1	中芯国际集成电路制造有限公司小计	18,255.73	20.37%	-
	2	中芯国际集成电路制造有限公司(北京)有限公司	14,794.07	16.60%	晶圆代工
	3	中芯国际集成电路制造有限公司(上海)有限公司	3,234.42	4.16%	晶圆代工
	4	中芯国际集成电路制造有限公司(天津)有限公司	137.24	0.15%	晶圆代工
	5	英特尔	14,433.59	16.10%	成品芯片
2012年度	1	砂晶精密工业股份有限公司小计	12,743.07	14.22%	-
	2	砂晶科技(苏州)有限公司	12,742.83	13.83%	封装测试
	3	砂晶精密工业股份有限公司	359.24	0.39%	封装测试
	4	台湾积体电路制造股份有限公司	5,210.92	5.81%	封装测试
	5	合计	82,258.33	91.77%	-

截至2019年5月21日,国家集成电路基金间接持有中芯国际集成电路制造有限公司19.41%股份,中芯国际集成电路制造有限公司(北京)有限公司,中芯国际集成电路制造(上海)有限公司和中芯国际集成电路制造(天津)有限公司系受同一实际控制人中芯国际集成电路制造有限公司控制的企业,为公司主要晶圆代工工厂之一。

截至2019年6月30日,国家集成电路基金持有江苏长电科技股份有限公司19%股份,为其大股东;持有华天科技(西安)有限公司27.23%股份,为其第二大股东,江苏长电科技股份有限公司和华天科技(西安)有限公司为公司主要封装测试厂。

国家集成电路基金是经国务院批准,为促进国内集成电路产业发展而设立的国家产业投资基金,主营业务为投资集成电路行业重点企业,重点投资集成电路芯片制造,兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业。自2014年9月成立以来,国家集成电路基金投资了国内多家集成电路行业企业。2017年12月,基于公司领先的技术实力和良好的经营业绩及增长前景,国家集成电路基金入股公司,持有公司7.00%的股份。

公司与中芯国际、江苏长电科技股份有限公司、华天科技(西安)有限公司之间的交易属于正常商业行为,交易价格公允,中芯国际、江苏长电科技股份有限公司不存在为公司代垫费用、输送利益的情形。根据《公司法》、《企业会计准则》第36号—关联方披露等相关法律法规、法规和规范性文件的规定,中芯国际、江苏长电科技股份有限公司、华天科技(西安)有限公司不属于公司的关联方。除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人、主要关联方和其他持有公司5%以上股份的股东未在上述供应商中拥有权益。上述供应商与公司及实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

报告期内,公司前五大供应商基本情况如下:

序号	公司名称	基本情况	性质	进入前五年份
1	中芯国际集成电路制造有限公司	成立于2006年,总部位于中国上海,中国内地规模最大的集成电路制造企业,已向全球主要证券交易所上市。	晶圆代工	2016年
2	格罗方德	成立于2009年,总部位于美国,全球知名的半导体制造商,已向全球主要证券交易所上市。	晶圆代工	2016年
3	砂晶精密工业股份有限公司	成立于1984年,总部位于中国台湾,全球最大的芯片封装测试企业,主要提供各类集成电路封装、测试服务。	封装测试	2017年
4	英特尔	详见招股说明书第六节之“三、(四)主要竞争对手情况”的相关内容。	成品芯片	2016年
5	台湾积体电路制造股份有限公司	成立于1987年,总部位于中国台湾,全球最大的晶圆代工企业,向全球客户提供晶圆代工服务,已向纽约证券交易所、纳斯达克交易所、台湾证券交易所、香港交易所上市。	晶圆代工	2016年
6	WPI International (Hong Kong) Limited	位于香港,是一家半导体零件分销商,为大型半导体客户提供半导体零件分销服务。	半导体零件分销	2017年
7	京隆科技(苏州)有限公司	成立于2002年,是全球著名的集成电路测试公司,台湾积体电路制造股份有限公司在中国大陆的全资子公司。台湾积体电路制造股份有限公司在台湾证券交易所股票代码:2340上市。	封装测试	2018年
8	天水华天科技股份有限公司	成立于2003年,总部位于中国甘肃天水市,是国内领先、国际著名封装测试厂,已在深圳证券交易所股票代码:002185上市。	封装测试	2019年1-6月

注:公司向WPI International Hong Kong Ltd采购产品为内存芯片裸片(即未封装的晶圆粒),与公司RK1608裸片进行多芯片封装(MCP, Multi-chip Package),从而提升整体应用解决方案的便捷性和性价比。

(五) 行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

1. 行业竞争情况

① 行业内的主要企业

英特尔成立于1968年,总部位于美国,全球最大的个人计算机零件和CPU制造商,产品应用在全球个人计算机、服务器、平板电脑、智能手机等众多领域,已在美国纳斯达克证券交易所上市。

② 联发科

联发科成立于1997年,总部位于中国台湾,主要从事无线通讯及数字多媒体技术领域的IC设计,提供的芯片整合系统解决方案包含智能手机、平板电脑无线通讯、高清数字电视、光存储、DVD及蓝光等,已在台湾证券交易所上市。

③ 海思半导体

深圳市海思半导体成立于2004年,总部位于中国深圳,华为技术有限公司的控股公司,主要从事消费类电子、通信等领域的芯片与模块解决方案,产品主要运用于智能手机、视频监控、IPTV等。

④ 晨星半导体

晨星半导体(上海)股份有限公司成立于2003年,总部位于中国上海,在视频、音频和图像处理领域提供先进的产品解决方案,广泛应用于数字电视、数码相机、家庭媒体中心和机顶盒等消费电子产品。

⑤ 德州仪器

德州仪器是全球知名的半导体企业,总部位于美国,为世界领先的数字信号处理和模拟技术的设计商和供应商,主要产品包括微处理器、嵌入式处理器和无线产品等,已在纳斯达克交易所上市。

⑥ 同行业可比上市公司

基于相关性和可比性原则,在综合考虑同行业上市公司业务模式、产品结构的基础上,公司选取珠海全志科技股份有限公司、中颖电子股份有限公司、北京君正集成电路股份有限公司、圣邦微电子(北京)股份有限公司、深圳市富满电子集团股份有限公司、晶晨半导体(上海)股份有限公司等六家公司作为同行业可比上市公司。上述公司的芯片产品应用领域,与公司较为接近或有所重叠:除深圳市富满电子集团股份有限公司部分封装测试自行生产完成外,上述公司均采用Fables模式,主要从事集成电路设计,芯片的生产、封装和测试等主要通过委外方式实现。

① 珠海全志科技股份有限公司

珠海全志科技股份有限公司(股票代码:300458)成立于2007年9月,总部位于珠海,主要从事智能应用处理器SoC芯片及智能电源管理芯片等集成电路设计、产品可广泛应用于平板电脑、高清视频、移动互联网设备、智能家居、行车记录仪等智能终端设备。2018年,该公司实现营业收入13.65亿元,净利润1.08亿元。

② 中颖电子股份有限公司

中颖电子股份有限公司(股票代码:300327)成立于1994年7月,总部位于上海,主要从事单片机MCU、集成电路设计和销售,主要产品应用于笔记本PC、智能手机、平板电脑、电动工具、电动自行车、UPS和移动基站等领域的锂电池管理和保护。2018年,该公司实现营业收入4.56亿元,净利润1.61亿元。

③ 北京君正集成电路股份有限公司

北京君正集成电路股份有限公司(股票代码:300223)成立于2005年7月,总部位于北京,主要从事嵌入式CPU芯片及配套软件平台的研发和销售,产品主要应用于移动设备供应链领域,如便携消费电子、便携教育电子、移动互联网终端设备等。2018年,该公司实现营业收入2.60亿元,净利润0.14亿元。

④ 圣邦微电子(北京)股份有限公司

圣邦微电子(北京)股份有限公司(股票代码:300661)成立于2007年1月,总部位于北京,主要从事电源管理、信号链芯片产品等集成电路设计行业,产品可广泛应用于手机、电视、DVD、数码相机、笔记本电脑、消费电子产品、汽车电子、工业自动化控制、医疗设备、液晶显示等众多领域。2018年,该公司实现营业收入5.72亿元,净利润1.04亿元。

⑤ 深圳市富满电子集团股份有限公司

深圳市富满电子集团股份有限公司(股票代码:300671)成立于2001年11月,总部位于深圳,主要从事电源管理类芯片、LED驱动及驱动类芯片等集成电路设计行业,产品主要应用于平板电脑、蓝牙耳机、LED显示和照明市场、移动终端等。2018年,该公司实现营业收入4.97亿元,净利润0.53亿元。

⑥ 晨星半导体(上海)股份有限公司

晨星半导体(上海)股份有限公司成立于2003年7月,总部位于上海,主要从事多媒体智能终端SoC芯片的研发、设计与销售,产品主要应用于智能机顶盒、智能电视和AI音视频系统终端等领域。2018年,该公司实现营业收入23.69亿元,净利润2.82亿元。

2. 发行人在行业中的竞争地位
公司致力于系统级SoC芯片的研究和开发,是国内具有自主研发能力并掌握核心技术集成电路设计企业之一。

公司坚持创新引领、前瞻布局,是国内应用处理器芯片设计企业向高性能领域拓展的先鋒企业之一。在消费电子和智能物联应用处理器领域,公司先后推出了一系列性能较为领先的中高端应用处理器芯片,其中中高端芯片的性能均显著高于同时期、国内其他芯片设计企业新产品的性能。2018年3月,全球科技市场权威研究机构IC Insights发布2017年度全球Fables芯片供应商50名排名榜,包括公司在内的10家中国大陆企业位列其中。

在消费电子应用领域,公司高端SoC芯片产品正逐步进入国际高端消费电子市场,公司先后与英特尔合作推出SoFia 3GR芯片产品,与谷歌和三星合作推出Chromebook笔记本平板电脑和平板电视,成为国内少数与英特尔、谷歌、三星等国际IT行业巨头均有深度合作的中端集成电路设计企业之一。

在智能物联应用领域,公司是国内少数具备国际竞争力的设计企业之一,公司的SoC芯片产品正在广泛应用于个人智能家居系统平台、智慧商显、智能零售、汽车电子、智能安防等领域,应用领域广泛,市场占有率较高,有效地带动了传统产业的转型升级、服务、支持和促进了新经济的发展。

公司在构建较为丰富产品线、拓展产品应用领域的同时积极布局人工智能,自2017年以来,已陆续推出了多款人工智能SoC芯片产品。2018年4月,全球科技市场权威研究机构Compass Intelligence,LLC发布全球人工智能企业排行榜,公司位列全球第20位,在中国大陆企业中仅次于华为海思半导体位列第2位。

公司是国家级高新技术企业、国家规划布局内集成电路设计企业、工业和信息化部软件与集成电路促进中心评选的“十年(2001-2010)中国“领军”设计企业,报告期内公司芯片产品多次获得中国芯评选的“最佳市场表现奖”。公司芯片产品已陆续被三星、索尼、华为、OPPO、VIVO、华硕、海尔、腾讯、宏碁等国内外品牌厂商采用,形成了良好的品牌、口碑和行业地位。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

(一) 主要固定资产

公司的固定资产主要包括房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备等。截至2019年6月30日,公司固定资产情况如下:

项目	原值	净值	成新率
房屋建筑物	2,015.60	1,145.93	56.85%
通用设备	527.56	160.85	30.49%
专用设备	4,833.33	1,333.97	28.01%
运输设备	129.35	6.47	5.00%
合计	7,505.84	2,667.22	35.54%

1. 自有房产

截至本招股意向书摘要签署日,公司拥有房屋建筑物如下:

权利人	房屋座落	面积(㎡)	登记时间	用途	产权证号	抵押
发行人	鼓楼区软件大道18号楼	3,316.57	2016/1/13	科研	粤房地权证字第1600283号	无
发行人	鼓楼区软件大道89号21楼	3,363.20	2016/1/13	科研	粤房地权证字第1600283号	无

2. 租赁房产

截至本招股意向书摘要签署日,公司租赁房屋建筑物如下:

发行人	开发有限公司	福州软件园产业基地福州软件园A区20号楼	3,461.23	2015/6/15-2016/6/30	科研
深圳分公司	深圳万利达电子工业有限公司	深圳市南山区科技园万利达科技大厦21层	2,511.45	2015/5/26-2016/5/26	办公研发
北京分公司	都会洪业(天津)有限公司 北京欧美汇商务中心 出租分公司	北京市海淀区海淀东三街2号 欧美汇大厦1301-04单元	790.00	2016/12/01-2019/11/30	写字楼
北京分公司	北京东升春物业管理有限公司	北京市海淀区知春路6号铭悦国际中心B座303室	598.36	2019年6月-2021/9/5	办公
上海分公司	上海中新高泰科技企业管理中心	上海市浦东新区盛夏路500弄156号6楼	1,062.17	2018/11/16-2019/11/15	办公
杭州牧创	杭州高新嘉技术产业开发有限公司 杭州科技创业服务中心	杭州西湖西溪天目山路199号创业大厦418室	428.00	2017/9/16-2019/9/15	科研
上海翰迪	上海中新高泰科技企业管理中心有限公司	上海市浦东新区盛夏路500弄2号6楼608室	1,069.70	2018/11/16-2019/11/15	办公
香港瑞芯微	LAW SUT KAM	香港新界元朗13楼安泰街11号好景大厦7107-2019/3/9	88.44	2018/3/10-2020/3/9	工业